



电子行业简评报告：斯达半导 增发过会 IDM 模式布局新能 源车市场



斯达半导 35 亿非公开过会，IDM 模式布局高压 IGBT 及 SiC 芯片。

2021 年 9 月 24 日，斯达半导发布公告，公司非公开发行 A 股股票申请获得证监会发审委审核通过。本次非公开增发拟募集资金不超过 35 亿元，主要用于高压 IGBT 芯片、SiC 芯片的研发及生产，以及功率半导体模块生产线自动化改造。

具体来看：(1) 15 亿用于高压 IGBT 芯片研发及产业化。完工后 6 吋高压 IGBT 产能预计将达 30 万片/年。高压 IGBT 主要用于智能电网、轨道交通、风力发电等领域。(2) 5 亿用于 SiC 芯片研发及产业化。

达产后 6 吋 SiC 芯片产能预计将达 6 万片/年。SiC 是目前主流的第三代半导体芯片，被广泛应用于新能源汽车等新兴高端行业市场。(3) 7 亿用于功率半导体模块生产线自动化改造。完工后预计新增产能 400 万块/年。(4) 8 亿用于补充流动资金。

IDM 模式更有利于开拓新能源车市场。安全等级较高的整车厂对芯片的寿命、可靠性以及失效率要求较高，芯片需经过多轮筛选及测试才能拿去封装。封装后的模块仍要经过严格测试才能出货给整车厂。

IDM 模式相较于 Fabless 能够保证整车厂从芯片生产的源头上把控芯片质量，从而确保整车安全。因此，拥有晶圆生产线的厂商更易获得新能源汽车厂商的订单。

电子板块行情强于大盘

9月22日至9月24日，上证指数下跌0.02%，中信电子板块上涨0.7%，跑赢大盘0.7个百分点，9月20日至9月24日，费城半导体指数上涨1.0%。年初至今，上证指数上涨4%，中信电子板块上涨7%，跑赢大盘3个百分点，费城半导体指数同样上涨，涨幅23.6%。

电子各细分行业涨幅

9月22日至9月24日，涨幅前五的细分板块分别为分立器件、半导体设备、消费电子设备、被动元件以及消费电子，涨幅分别为6.8%、6.7%、4.1%、2.8%以及1.8%。上周仅有4个细分板块发生下跌，分别为面板、安防、光学光电以及显示零组，分别下跌5.1%、3.7%、2.9%以及2.8%。

个股涨跌幅：A股

9月22日至9月24日，涨幅前五的公司分别为盛洋科技、嘉元科技、上海贝岭、拓邦股份和麦捷科技，分别上涨18.21%、18.17%、15.66%、14.10%以及13.08%。跌幅前五的公司分别为弘信电子、汉威科技、联合光电、电连技术和苏大维格，分别下跌15.3%、9.7%、9.2%、8.6%以及8.5%。

投资建议

推荐关注功率半导体相关标的士兰微、斯达半导、宏微科技。

风险提示

产品研发不及预期、客户拓展不及预期。

关键词: 安防 新能源 新能源汽车 智能电网 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27071

